

PK504

Thermal Conductive Gel Pad

LiPOLY PK504 は熱伝導率5.0 W / m*Kの隙間充填材です。硬さは Shore OO/50で、高柔軟性、高絶縁耐圧、粘着性が良く、機構の設計公差は補ます。安定性が高いので、形は標準サイズからオーダーメイドフォーミング形までも対応できます。

■ 製品の特性

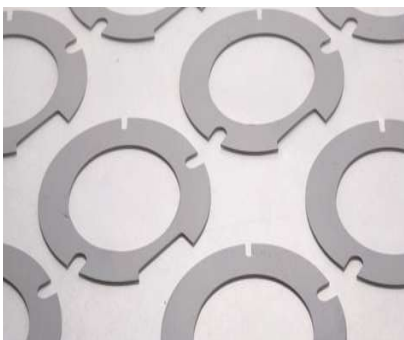
/ 熱伝導率: 5.0 W/m*K
/ 表面には自粘性があって、作業しやすい
/ 熱抵抗性低い
/ 色んな厚さは選べます

■ 製品アプリケーション

/ ノートパソコン
/ ヒートパイプモジュール
/ メモリモジュール
/ TV ハードデバイス
/ 自動車電気装置
/ モバイルデータ通信
/ 高速記憶装置
/ セットトップボックス
/ ネットワークカメラ
/ 5Gの基地局(基幹施設/設備)
/ 電気自動車

■ 製品の形

/ ロール状 / シート状
/ フォーミング形



■ TYPICAL PROPERTIES

PROPERTY	PK504	TEST METHOD	UNIT
Color	Gray	Visual	-
Surface tack 2-side/1-side	2	-	-
Thickness	Customized	ASTM D374	mm
Density	3.0	ASTM D792	g/cm ³
Hardness	50	ASTM D2240	Shore OO
Application temperature	-60~180	-	°C
ROHS & REACH	Compliant	-	-
COMPRESSION@1.0mm			
Deflection @10 psi	13	ASTM D5470 modify	%
Deflection @20 psi	17	ASTM D5470 modify	%
Deflection @30 psi	22	ASTM D5470 modify	%
Deflection @40 psi	27	ASTM D5470 modify	%
Deflection @50 psi	31	ASTM D5470 modify	%
ELECTRICAL			
Dielectric breakdown	12	ASTM D149	KV/mm
Surface resistivity	>10 ¹¹	ASTM D257	Ohm
Volume resistivity	>10 ¹⁰	ASTM D257	Ohm-m
THERMAL			
Thermal Conductivity	5.0	ASTM D5470	W/m*K
Thermal impedance@10 psi	0.415	ASTM D5470	°C-in ² / W
Thermal impedance@20 psi	0.393	ASTM D5470	°C-in ² / W
Thermal impedance@30 psi	0.358	ASTM D5470	°C-in ² / W
Thermal impedance@40 psi	0.336	ASTM D5470	°C-in ² / W
Thermal impedance@50 psi	0.307	ASTM D5470	°C-in ² / W

Thermal Resistance vs. Pressure vs. Deflection

